

# Produktdatenblatt

VarPol Stiftleiste gerade 2-reihig,  
Art. Nr. 972-nn053-ba

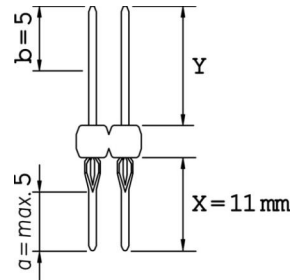


Abbildung ähnlich



Parallel



Einpresstechnik

- Länge Steckseite (Y) = 13.0 mm
- Einpresstechnik
- Anschlusslänge 11 mm
- Polzahl 2 - 108 (Polzahl / Reihe entspricht nn in Artikelnummer)
- 2-reihig
- b in Artikelnummer definiert die Gütestufe der Steckseite; a definiert die Gütestufe der Anschlussseite



» zum Produkt auf [www.ept.de](http://www.ept.de)



» zur Produktgruppe Varpol connectors

# Produktdatenblatt

VarPol Stifftleiste gerade 2-reihig,  
Art. Nr. 972-nn053-ba



## Technische Daten

### Grundlagen

Anzahl Kontakte	2 - 108
Anschluss technik	Einpresstechnik
Anschlusslänge	11 mm
Leiterplattenabstand	19.45 mm - 23.45 mm
Betriebstemperatur	-55°C bis +125°C

### Material

Isolierkörper	PBT glasfaserverstärkt, UL 94 V-0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung

### Mechanisch

Rastermaß	2.54 mm
Steckkraft pro Kontakt	max. 0.9 N
Ziehkraft pro Kontakt	min 0.6 N

### Elektrisch

Betriebsstrom	max. 1.9 A
Betriebsspannung	150 V
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
Luft- und Kriechstrecke	1.2 mm
Isolationswiderstand	> 10 <sup>6</sup> MΩ

### Zulassungen / Konformität

UL file	E130314
Umwelt	RoHS konform

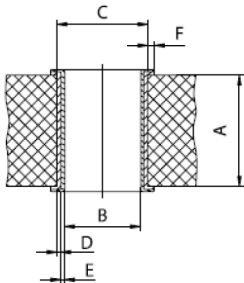
# Produktdatenblatt

VarPol Stiftleiste gerade 2-reihig,  
Art. Nr. 972-nn053-ba



## Lochspezifikation

Schichtaufbau nach IEC 60352-5



Material	chem. Sn Leiterplatten
<b>Nennloch</b>	<b>Ø 1.0 mm</b>
A Leiterplattendicke	min 1.44 mm
B Endloch	Ø 1.0 +0.09 / -0.06 mm
C Grundbohrung	1.15 ±0.025 mm
D Cu Schicht	min. 25 µm
E Oberfläche	chem. Sn Schicht, max. 1.5 µm
F Restring	min. 0.1 mm

Material	Ni, Au Leiterplatten
<b>Nennloch</b>	<b>Ø 1.0 mm</b>
A Leiterplattendicke	min 1.44 mm
B Endloch	Ø 1.0 +0.09 / -0.06 mm
C Grundbohrung	1.15 ±0.025 mm
D Cu Schicht	min. 25 µm
E Oberfläche	Ni, Au Schicht, 0.05 - 0.2 µm Au über 2.5 - 5 µm Ni
F Restring	min. 0.1 mm

Material	rein Cu Leiterplatten
<b>Nennloch</b>	<b>Ø 1.0 mm</b>
A Leiterplattendicke	min 1.44 mm
B Endloch	Ø 1.0 +0.09 / -0.06 mm
C Grundbohrung	1.15 ±0.025 mm
D Cu Schicht	min. 25 µm
E Oberfläche	OSP, z.B. GLICOAT-SMD (F2) mit 0.12 - 0.15 µm
F Restring	min. 0.1 mm

Material	HAL Sn Leiterplatten
<b>Nennloch</b>	<b>Ø 1.0 mm</b>
A Leiterplattendicke	min 1.44 mm
B Endloch	Ø 1.0 +0.09 / -0.06 mm
C Grundbohrung	1.15 ±0.025 mm
D Cu Schicht	min. 25 µm
E Oberfläche	HAL Sn, 5 - 15 µm
F Restring	min. 0.1 mm

# Produktdatenblatt

VarPol Stiffliste gerade 2-reihig,  
Art. Nr. 972-nn053-ba

---



## Zeichnungen

Die Kundenzeichnungen sowie 3D-Daten zu diesem Produkt können Sie hier herunterladen:

[» PDF](#)